

第63期  
中間事業報告書

平成13年4月1日～平成13年9月30日



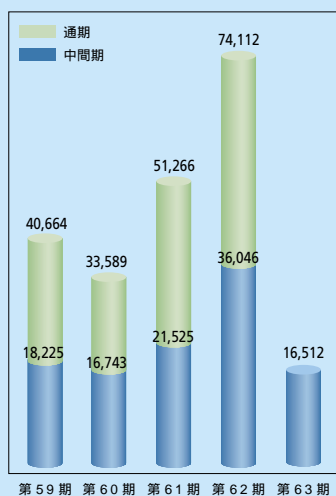
discco

# 主要財務数値(中間期)

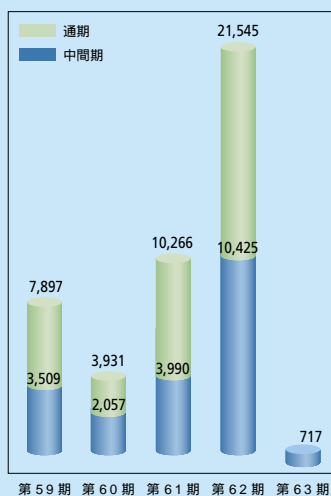
(連結)

	平成10年3月期 59期中間期	平成11年3月期 60期中間期	平成12年3月期 61期中間期	平成13年3月期 62期中間期	平成14年3月期 63期中間期
売上高(百万円)	18,225	16,743	21,525	36,046	16,512
経常利益(百万円)	3,509	2,057	3,990	10,425	717
中間純利益(百万円)	1,641	962	1,192	5,752	625
1株当たり中間純利益(円)	80.14	45.86	56.77	179.12	19.48
株主資本(百万円)	23,165	26,128	27,999	45,546	50,230
総資産(百万円)	42,522	42,338	49,232	75,439	66,085
株主資本中間純利益率(%)	7.6	3.7	4.3	13.3	1.2

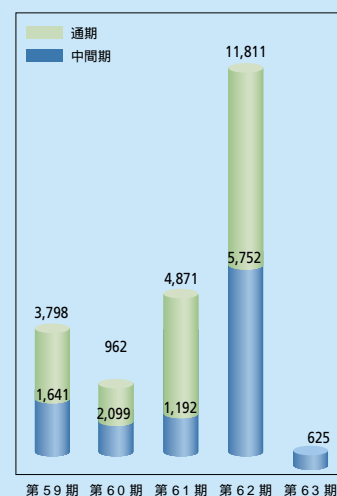
[売上高(百万円)]



[経常利益(百万円)]



[当期純利益(百万円)]



### IT不況を背景に大幅な売上減を計上

当中間期における日本経済のみならず世界経済は、総じて景気の減速または後退が鮮明になりました。半導体業界や電子部品業界では、いわゆるIT不況により、パソコン、携帯電話をはじめとする最終需要の減退が続き、前年中間期とは違って変わって設備投資が大幅に削減されました。

このような状況のもとで、当社は、積極的な営業活動を展開いたしました。ユーザーである半導体メーカーや電子部品メーカーの設備投資削減の流れを覆すにはいたりませんでした。各種のコスト削減、不採算子会社の売却などを進め、損益の改善努力を続けましたが売上高の減少を補うにはいたらず、当中間期の連結売上高は165億12百万円(前年同期比54.2%減)、連結経常利益は7億17百万円、連結中間純利益は6億25百万円を計上いたしました。



代表取締役社長 溝呂木 斉

### 新たな市場を見据え、さらなる研究開発に注力

半導体業界、電子部品業界におきましては、中長期的にはIT化、ブロードバンド化の進展を睨んで部品の高速・大容量化、低消費電力化、微細化などの技術革新が着実に進んでいくものと予想されます。こうした流れを受け、当社に対するユーザーの技術的要求はますます高度化、多様化してきており、このトレンドは今日のような不況期におきましても変わることはありません。

当社としましては、業績の改善を図るため、人件費をはじめコスト削減策を強力に推進してまいります。一方で、新製品・新技術の開発に重点的に取り組んでまいります。中長期の飛躍を見据えて研究開発のための投資も積極的に行ってまいります。

また、将来のビジネスの種として、微細加工を要する各種電子部品、電子材料などの分野で、当社の強みの一つであるアプリケーション技術を駆使して、新たな市場・用途の開拓に注力してまいります。

### 配当について

今回のシリコンサイクル(半導体業界の需給バランスによる好不況の循環)の下降局面は、予想以上に調整速度が速く、かつ深いものとなっております。当社の当中間期につきましては、平成5年3月期以来の赤字計上を余儀なくされることとなりました。米国同時多発テロ等による世界景気の一層の冷え込み等、先行きにつきましても非常に不透明であります。

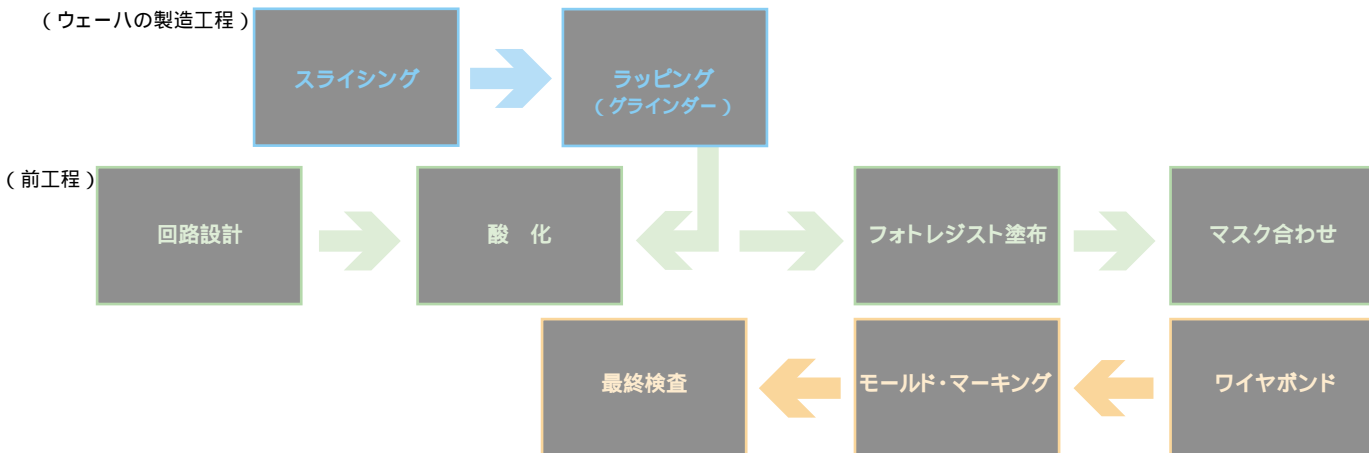
以上を踏まえ、中間配当金につきましては、誠に遺憾ながら一株につき10円(前期15円)とさせていただきます。

今後の厳しい経営環境を見据えて、コスト削減策、さらなる研究開発と新たな市場・ニーズの開拓などを通して、この難局を乗り切ってゆく所存です。

株主の皆様におかれましては、より一層の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 溝呂木 斉

## 半導体製造プロセスにおけるディスコ製品の位置付け



ダイシングソー(写真1)

エレクトロニクス製品の心臓部には、もれなく半導体が組み込まれており、この半導体を製造するために使われる機械装置が半導体製造装置です。

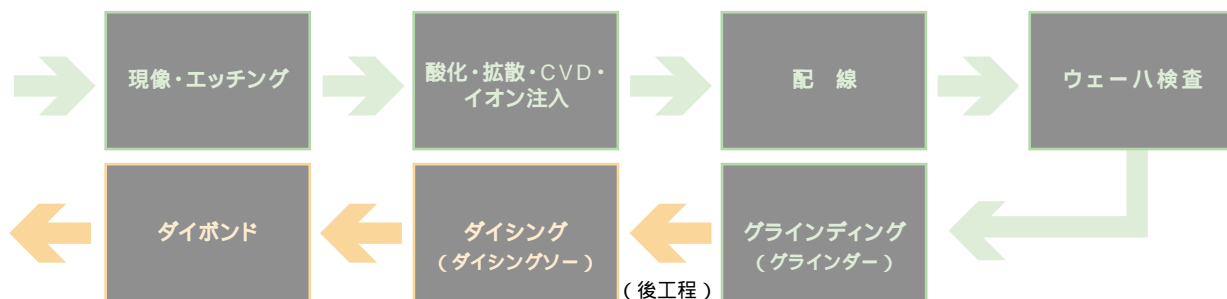
ところで、半導体の製造工程は、大別するとウェーハと呼ばれる薄い円盤状のシリコンを製造する工程(ウェーハ製造工程)そのウェーハの上に複雑な数百にのぼるICを形成する工程(前工程)そして数百個のICを一つ一つのチップに切り分けて組み立て・パッケージングをして最終検査をする工程(後工程)からなり、それらがさらに上図のとおり、多くの工程により構成され、その各工程毎に専用の半導体製造装置が使用されております。

ウェーハの製造は、主にシリコンのインゴット(塊)を輪切りする「スライシング」、ウェーハの表

面を平坦に研磨する「ラッピング」などからなります。

前工程には、300～400に上る膨大な工程がありますが、主なものをあげると回路のレイアウト・配線を設計しICのパターンをウェーハに焼き付けるためのマスクを作成する「回路設計(フォトマスク作成)」、高温の拡散炉でウェーハ表面に酸化膜を成形する「酸化」、感光剤をウェーハの表面に塗布する「フォトレジスト塗布」、ウェーハとマスクを位置決めしてICパターンを焼き付ける「マスク合わせ」、現像し、酸化膜からウェーハ面を露出する「現像・エッチング」、ウェーハ露出面に半導体を形成する「酸化・拡散・CVD・イオン注入」、ウェーハ表面に銅のメッキやアルミニウムを蒸着する「配線」、ウェーハ上にできあがったICチップを検査する「ウェーハ検査」、ウェーハの厚み

ディスコの企業像をさまざまな側面から紹介するDISCO TODAY。今回は半導体製造プロセスのどこに、ディスコ製品が使われているかについてご紹介します。



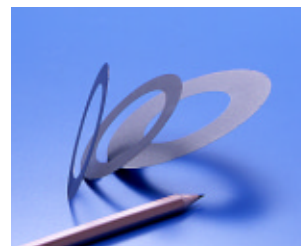
を設計寸法まで薄く削る「グラインディング」があります。

後工程には、ウェーハ上のチップを一つ一つに切り分ける「ダイシング」、チップをリードフレームの所定の位置に固定する「ダイボンド」、それをワイヤーで配線する「ワイヤボンド」、樹脂・セラミックでIC全体を封止し、品名等を印刷する「モールド・マーキング」などがあり、最後の「最終検査」工程を終え、製品として出荷されます。

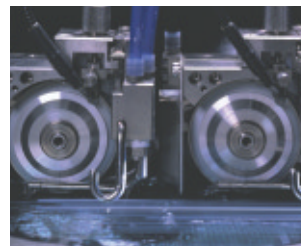
以上の工程のうち、当社の主力製品であるダイシングソー(写真1)は、後工程の1番最初の「ダイシング」(ウェーハを1個づつ裏の目に切断する)工程に用いられています。ウェーハからICチップをミクロン単位の精度で一つ一つ切り出すための精密研削切断装置です。わずか数十ミクロン厚のダイヤモンドブレード(写真2)を毎分数

万回転で高速回転させ、切り屑や発熱除去のために加工点に純水をかけながら切断します。(写真3)近年の傾向としては、生産性の向上、製造コストの削減等の理由から、大口径ウェーハ(直径300mm対応)向け機種やガリウム、ゲルマニウムなどの化合物半導体などといったシリコン以外への切断加工のニーズがあります。

また、当社のグラインダーは、ダイヤモンドパウダーを主成分とするグラインディング・ホイールを装着し、ウェーハを薄く、かつ平坦に研削加工する装置で、シリコンウェーハを製造する際の「ラッピング」工程や前工程の最後である「グラインディング」工程で使用されています。最近の傾向としては、チップを幾層にも重ねる積層型IC用チップやICカード用チップなどに代表されるように、極薄加工へのニーズが高まってきております。

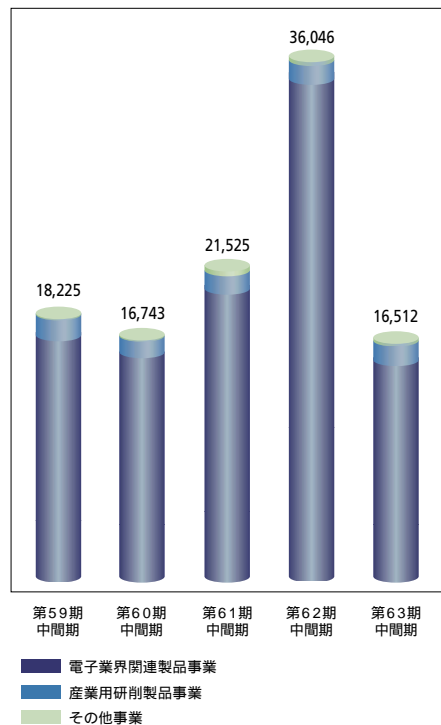


ダイヤモンドブレード(写真2)



ICチップの切り出し(写真3)

[部門別売上高推移 (百万円)]



ダイシングソー

当社の事業の種類別セグメントは、主に半導体メーカー、電子部品メーカー向けにダイシングソー、グラインダー、精密ダイヤモンド砥石などを製造販売している電子業界関連製品事業、建設・土木業界向けにダイヤモンドホイールなどを製造販売している産業用研削製品事業、コンピュータシステムのソフト・ハードの開発販売からなるその他事業の3つに分けられます。このうち電子業界関連製品事業が売上高規模で90%以上を占めており、主たる収益源となっています。

## 電子業界関連製品事業

昨年後半からのIT不況、生産・在庫調整の長期化を受け、半導体メーカー、電子部品メーカーは業績の低迷と設備投資の削減が顕著になっています。

当連結中間期におきましては、半導体メーカー、電子部品メーカーによる設備投資の削減と生産稼働率の大幅低下により、ダイシングソー、グラインダーなどの機械装置や精密ダイヤモンド砥石などの消耗品の受注が大幅に減少した結果、部門売上高は前年同期比56.6%減の149億60百万円となりました。

地域別では、すべての地域で売上高が落ち込みました。特に、近年、半導体製造拠点の集積が顕著である台湾やシンガポールなどのアジア地域での減少が大きく、同地域での売上高は前年同期の3分の1程度にまで落ち込みました。

半導体および電子部品業界における設備投資は、短期的にはシリコンリサイクルの影響を受けながらも中長期的には上昇トレンドを描いてゆくものと期待されます。

当社は、今後の市場動向や技術動向を見据えながら、その独自の技術力により、着実な事業展開をまいります。

### 産業用研削製品事業

当部門は、ダイヤモンドホイール、研削切断砥石など主として建築・土木業界向けの研削切断工具の製造・販売を行っています。当中間期は、公共事業が抑制基調にあるなど、環境的には必ずしも良好であった訳ではありませんが、国内外で販売活動を積極的に展開した結果、売上高は13億62百万円と前年同期比3.5%の微増となりました。

なお、従来(株)ディスコにおいて、電子業界関連製品事業と本事業を併営しておりましたが、両事業ではビジネス環境が大きく異なっていることから、独立企業として利益責任をより明確にして、一層の経営効率化・事業の拡大を図るため、当事業を(株)ディスコより分社化しました。(平成13年9月(株)ディスコ アブレイシブ システムズを設立)



産業ダイヤモンド砥石

### その他事業

当部門は、半導体製造装置向けなどのコンピュータシステムのソフトウェアの開発・販売を主としています。前期まで連結対象子会社であった天然石材事業を行っている子会社が今中間期より連結対象からはずれたため、部門売上高は1億89百万円と、前年同期比27.9%減となりました。

# 財務諸表(連結)

## 連結貸借対照表

科 目	(単位:百万円)	
	62期通期 (平成13年3月31日現在)	63期中間期 (平成13年9月30日現在)
<b>(資産の部)</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	18,891	6,522
受取手形及び売掛金	21,092	10,007
棚卸資産	19,279	20,515
その他の資産合計	2,566	2,125
<b>流動資産合計</b>	<b>61,829</b>	<b>39,170</b>
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物及び構築物	8,661	8,819
機械装置及び運搬具	3,486	3,835
土地	5,707	5,704
その他	1,454	2,050
<b>有形固定資産合計</b>	<b>19,311</b>	<b>20,409</b>
<b>無形固定資産</b>		
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,116</b>	<b>1,026</b>
投資有価証券	1,664	1,624
その他	2,512	3,854
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>4,177</b>	<b>5,479</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>24,605</b>	<b>26,915</b>
<b>資産合計</b>	<b>86,435</b>	<b>66,085</b>

科 目	(単位:百万円)	
	62期通期 (平成13年3月31日現在)	63期中間期 (平成13年9月30日現在)
<b>(負債の部)</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形及び買掛金	14,251	5,344
短期借入金	2,874	3,878
一年内償還予定の社債	500	—
未払法人税等	7,223	708
その他	7,439	3,402
<b>流動負債合計</b>	<b>32,289</b>	<b>13,333</b>
<b>固定負債</b>		
退職給付引当金	1,661	1,604
その他	831	873
<b>固定負債合計</b>	<b>2,493</b>	<b>2,478</b>
<b>負債合計</b>	<b>34,782</b>	<b>15,811</b>
<b>(少数株主持分)</b>		
<b>少数株主持分</b>	<b>51</b>	<b>44</b>
<b>(資本の部)</b>		
<b>資本金</b>	<b>9,770</b>	<b>9,770</b>
<b>資本準備金</b>	<b>10,637</b>	<b>10,637</b>
<b>連結剰余金</b>	<b>31,472</b>	<b>30,285</b>
その他有価証券評価差額金	31	34
為替換算調整勘定	310	428
自己株式	0	0
<b>資本合計</b>	<b>51,601</b>	<b>50,230</b>
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	<b>86,435</b>	<b>66,085</b>

## 連結損益計算書

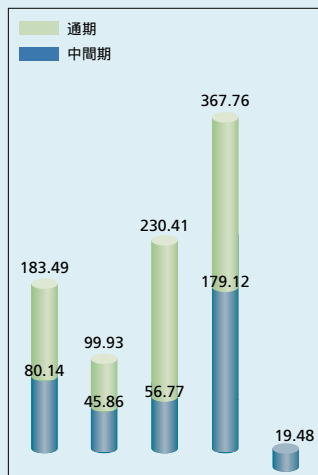
科 目	(単位:百万円)	
	62期中間期 (自平成12年4月1日 至平成12年9月30日)	63期中間期 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)
売上高	36,046	16,512
売上原価	17,331	9,282
売上総利益	18,714	7,229
販売費及び一般管理費	8,244	7,938
営業利益	10,470	708
営業外収益	189	181
営業外費用	233	190
経常利益	10,425	717
特別利益	62	32
特別損失	670	172
税金等調整前中間純利益	9,817	857
法人税、住民税及び事業税	4,711	134
過年度法人税等戻入額	—	534
法人税等調整額	646	169
少数株主利益	—	2
<b>中間純利益</b>	<b>5,752</b>	<b>625</b>

## 連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

科 目	(単位:百万円)	
	62期中間期 (自平成12年4月1日 至平成12年9月30日)	63期中間期 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,492	6,718
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,310	5,818
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,587	150
現金及び現金同等物に係る換算差額	18	17
現金及び現金同等物の増加額	387	12,369
現金及び現金同等物の期首残高	17,920	18,891
現金及び現金同等物中間期末残高	17,533	6,522

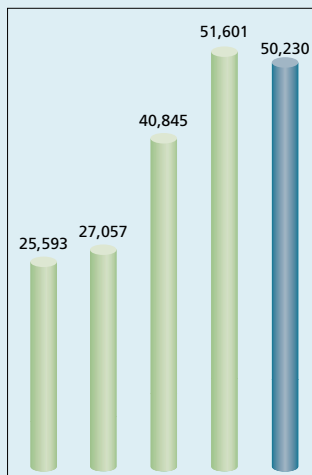
# 業績の推移(連結)

【一株当たり中間(当期)純利益(円)】



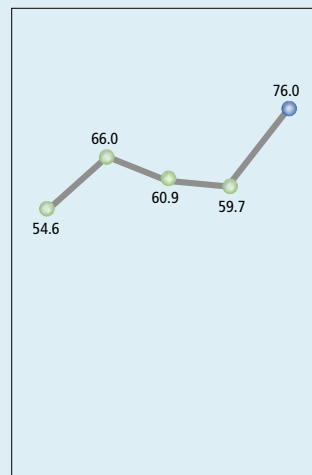
第59期 第60期 第61期 第62期 第63期

【株主資本(百万円)】



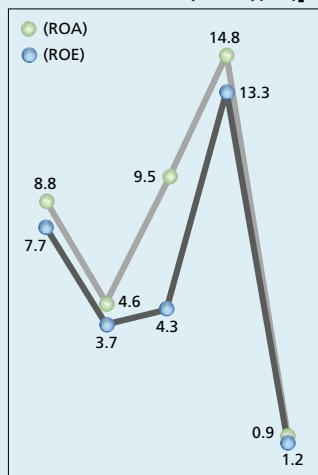
第59期 通期 第60期 通期 第61期 通期 第62期 通期 第63期 中間期

【株主資本比率(%)】



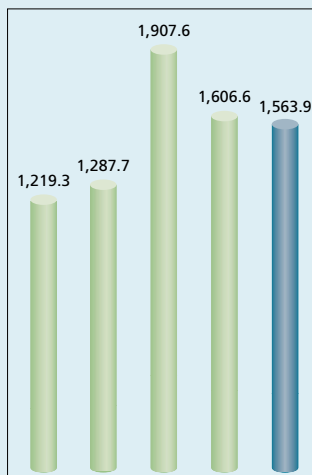
第59期 通期 第60期 通期 第61期 通期 第62期 通期 第63期 中間期

【総資産事業利益率(ROA) / 株主資本当期利益率(ROE % )】



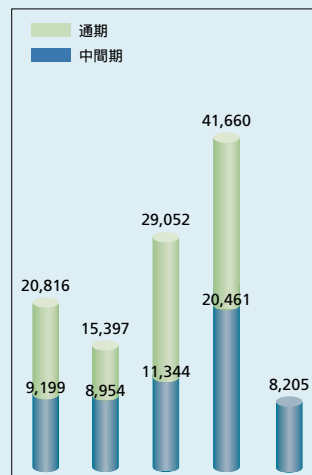
第59期 中間期 第60期 中間期 第61期 中間期 第62期 中間期 第63期 中間期

【一株当たり株主資本(円)】



第59期 通期 第60期 通期 第61期 通期 第62期 通期 第63期 中間期

【海外売上高(百万円)】



第59期 第60期 第61期 第62期 第63期

(注)事業利益 = 営業利益 + 受取配当金 + 受取利息

# 財務諸表(単独)

## 貸借対照表

科 目	(単位:百万円)	
	62期通期 (平成13年3月31日現在)	63期中間期 (平成13年9月30日現在)
<b>(資産の部)</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	15,493	3,674
受取手形	2,333	1,154
売掛金	12,965	6,337
棚卸資産	16,015	17,460
その他	4,057	4,784
<b>流動資産合計</b>	<b>50,865</b>	<b>33,411</b>
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	7,634	7,436
土地	4,983	4,983
その他	4,048	5,152
<b>有形固定資産合計</b>	<b>16,666</b>	<b>17,572</b>
<b>無形固定資産</b>		
投資その他の資産	819	766
投資有価証券	1,156	1,113
その他	4,722	6,291
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>5,879</b>	<b>7,405</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>23,365</b>	<b>25,744</b>
<b>資産合計</b>	<b>74,230</b>	<b>59,156</b>

## 損益計算書

科 目	(単位:百万円)	
	62期中間期 (自平成12年4月1日 至平成12年9月30日)	63期中間期 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)
売上高	29,366	11,331
売上原価	14,154	6,446
売上総利益	15,212	4,885
販売費及び一般管理費	6,733	6,258
営業利益	8,478	1,373
営業外収益	644	2,041
営業外費用	140	122
経常利益	8,982	545
特別利益	40	3
特別損失	1,224	162
税金等調整前中間純利益	7,798	386
法人税、住民税及び事業税	3,705	9
過年度法人税等戻入額		534
法人税等調整額	662	198
中間純利益	4,755	713
前期繰越利益	6,986	9,721
中間未処分利益	11,741	10,434

科 目	(単位:百万円)	
	62期通期 (平成13年3月31日現在)	63期中間期 (平成13年9月30日現在)
<b>(負債の部)</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形	5,715	2,099
買掛金	5,899	1,973
短期借入金	—	2,000
一年内償還予定の社債	500	—
未払法人税等	5,261	9
その他	5,925	2,397
<b>流動負債合計</b>	<b>23,302</b>	<b>8,478</b>
<b>固定負債</b>		
退職給付引当金	1,491	1,433
その他	787	804
<b>固定負債合計</b>	<b>2,278</b>	<b>2,237</b>
<b>負債合計</b>	<b>25,580</b>	<b>10,716</b>
<b>(資本の部)</b>		
<b>資本金</b>		
法定準備金	9,770	9,770
法定準備金	11,146	11,231
剰余金	27,701	27,471
(うち中間(当期)純利益)	(9,201)	(713)
その他有価証券評価差額金	31	34
<b>資本合計</b>	<b>48,649</b>	<b>48,440</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>74,230</b>	<b>59,156</b>

## 株価チャート



## 株主メモ

決算期	毎年3月31日
定時株主総会	毎年6月
利益配当金受領株主確定日	毎年3月31日
中間配当金受領株主確定日	毎年9月30日
名義書換代理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 東洋信託銀行株式会社
同事務取扱所	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 東洋信託銀行株式会社 証券代行部 TEL(03)5683-5111 (代表)
同 取 次 所	東洋信託銀行 全国各支店
公 告 掲 載 新 聞	日本経済新聞

### (お知らせ)

名義書換代理人 東洋信託銀行株式会社は、平成14年1月15日をもって、商号をUFJ信託銀行株式会社(登記上は、ユーエフジェイ信託銀行株式会社)に変更いたします。

### 商法改正のお知らせ

「商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)が、平成13年10月1日に施行されたので、概要をご案内申し上げます。

1. 単位株制度が廃止され、単元株制度になりました。  
当社は、100株を1単位としておりましたが、10月1日より100株を1単元といたしました。  
100株未満の買取請求につきましては従来どおりです。  
株主総会の議決権の数え方が、100株で1個となります。  
(250株ご所有の場合、従来は議決権株数200株と表示いたしておりましたが、今後は議決権数2個と表示いたします。)
2. 額面株式の制度が廃止されました。  
当社の株式は1株の額面金額を50円としていましたが、10月1日より額面株式の制度が廃止されましたので、全て無額面株式となりました。  
なお、現在ご所有の株券(1株の額面金額50円と記載)は、従来どおり証券取引所において流通いたしますので、株券お引き換えの手続きは一切ご不要でございます。

Visit Us!



ホームページアドレス  
<http://www.disco.co.jp/>





DISCO CORPORATION

